



持續創新改善 全員追求卓越

2023年第三季法人說明會

股票代號：6207

2023/12/19

LASER TEK TAIWAN CO., LTD.

免責聲明

本報告內容係依現有資訊而做成，上述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，是以本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。



大綱

- (一) 公司簡介
- (二) 2023年前三季營運成果
- (三) 設備產品研發核心技術與產業應用



(一)

公司簡介



全球奇聞聲譽品牌 · 聚焦核心光電技術 · 拓展利基藍海市場 · 提供完整服務方案



公司簡介

公司名稱：雷科股份有限公司

成立日期：1988年9月9日

資本額：新台幣 796,799 仟元

董事長：鄭再興先生

員工人數：集團員工約 300 人

營業項目：SMD 捲裝材料

LASER & 量測 設備

能源事業LED / GERMAGIC防疫系列產品

總公司地址：高雄市前鎮區新生路248-39號 (經濟部臨廣科技產業園區)

全球佈局雷科品牌，聚焦核心光電技術
拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



雷科集團營業據點

雷科-昆山
生產基地



雷科-東莞
發貨中心



雷科-新加坡



新竹分公司



高雄臨廣總公司

高雄新生大樓



全球佈局雷射品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案

雷科產品事業群



設備事業 (Laser & Metrology Equipments)

LASER 製程、檢測設備

METROLOGY設備、檢測設備



SMD捲裝材料事業 (Surface Mount Device Packaging Materials)

PCT 捲裝材料

ECT捲裝材料



能源事業LED / GERMAGIC防疫系列產品

LED 燈具

空氣清淨機

GERMAGIC防疫產品



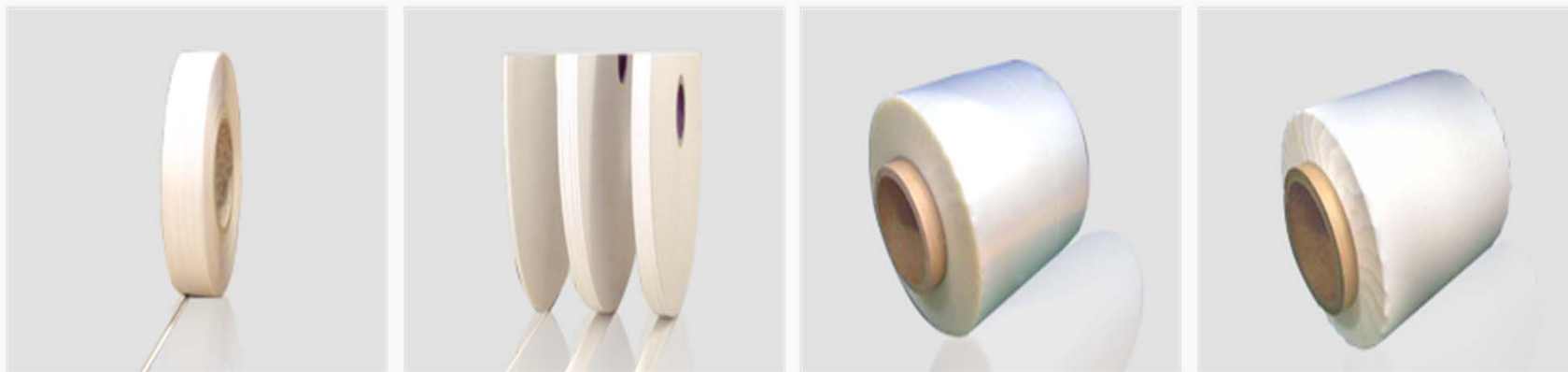
全球奇異品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案

LASERTEK TAIWAN CO., LTD.



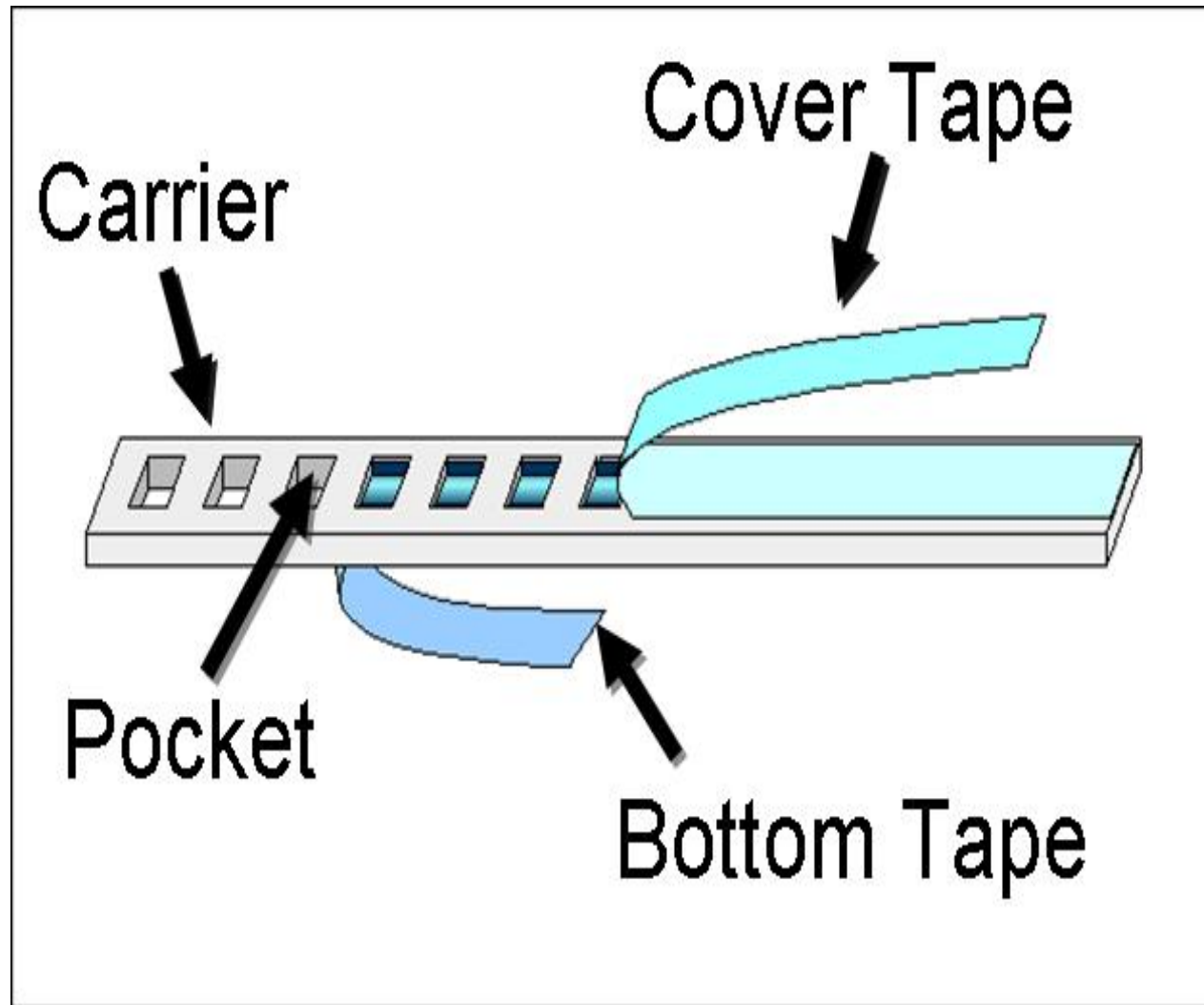
SMD捲裝材料事業 (Surface Mount Device Packaging Materials)

SMD-PCT 捲裝材料



LASER TEK TAIWAN CO., LTD.

SMD產品介紹 The structure of the conveyable tape



SMD PCT 主要客戶

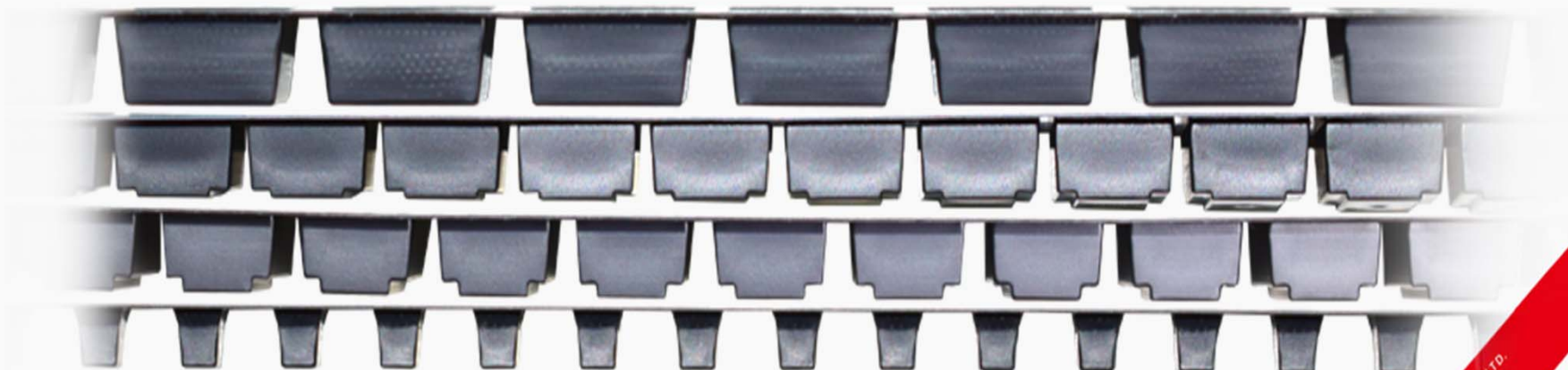


全球衛局電子品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



SMD捲裝材料事業 (Surface Mount Device Packaging Materials)

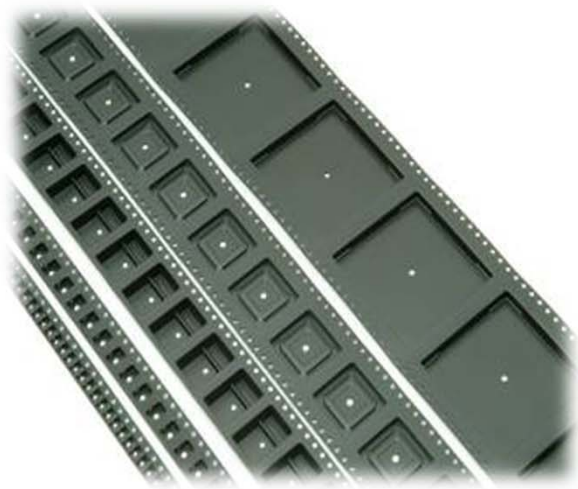
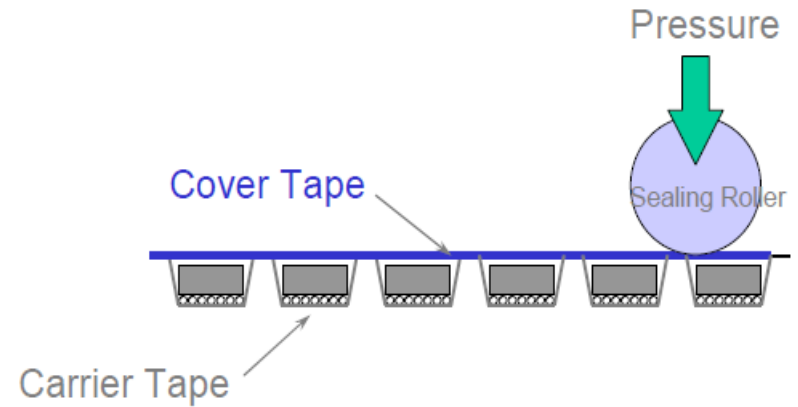
SMD-ECT 捲裝載帶



LASER TEK TAIWAN CO., LTD.

捲裝載帶 (Carrier Tape)

- Carrier Tape為：IC半導體、電子被動元件、LED產品等包裝捲帶，其材質最主要為PC、PS ...等塑膠原料。



主要IC封裝客戶



設備事業 (Laser & Metrology Equipments)



(二)

2023年前三季度營運成果



持續研開發新產品，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



綜合損益表

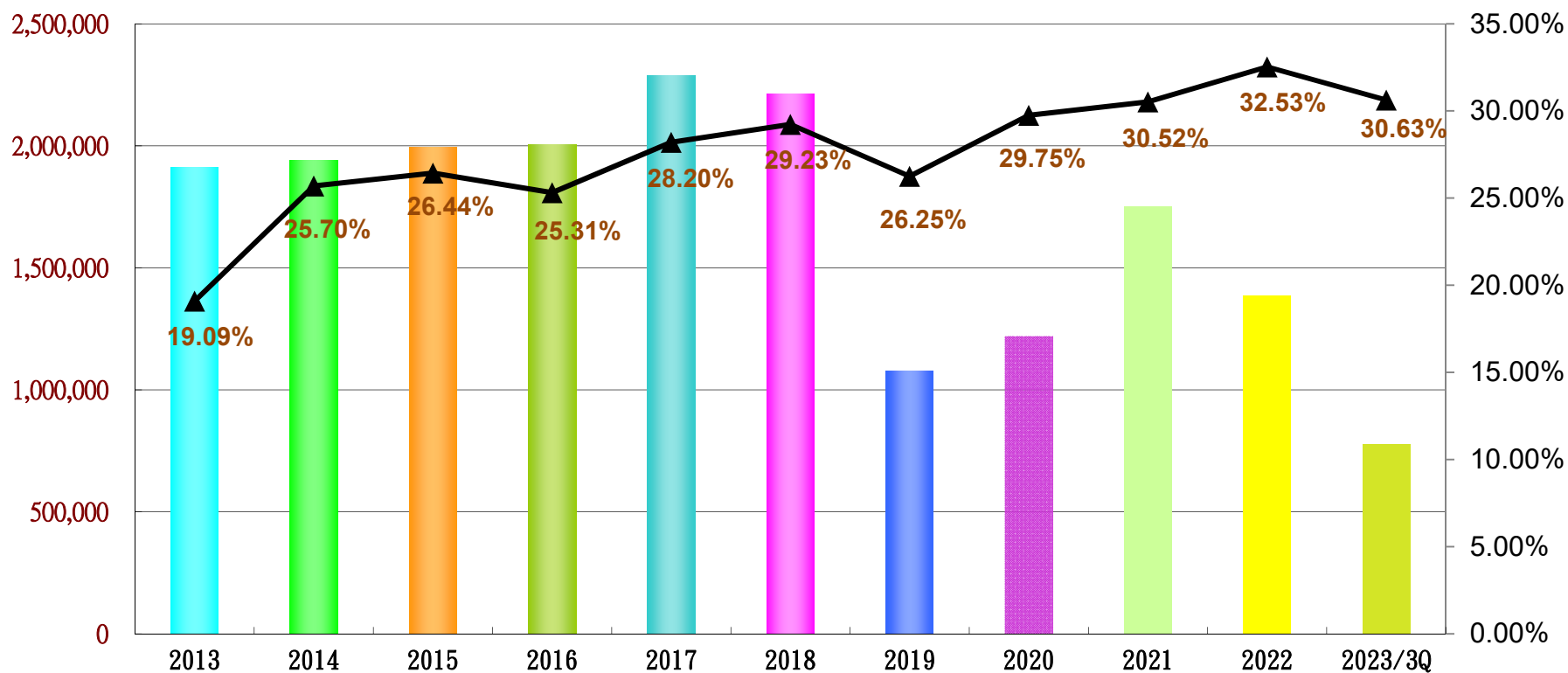
單位：新台幣仟元

項目	2023 3Q	2022 3Q	年差異%	2023/Q3單季	2022/Q3單季	季差異%
營業收入淨額	776,739	1,046,591	-25.78%	332,983	353,847	-5.90%
營業毛利率	30.63%	31.51%	-2.79%	29.56%	30.83%	-4.12%
營業費用	216,652	221,762	-2.30%	80,457	80,400	0.07%
營業淨利(損)	21,266	108,020	-80.31%	17,957	28,681	-37.39%
營業淨利率	2.74%	10.32%	-73.45%	5.39%	8.11%	-33.54%
營業外收入及支出	122,305	90,399	35.29%	37,983	42,913	-11.49%
歸屬於母公司業主之本期淨利(損)	115,371	158,034	-27.00%	44,485	55,941	-20.48%
純益率	14.85%	15.10%	-1.66%	13.36%	15.81%	-15.50%
每股盈餘(新台幣元)	1.45	1.88	-22.87%	0.56	0.67	-16.42%
股東權益報酬率	6.41%	9.62%	-33.37%	2.38%	3.31%	-28.10%

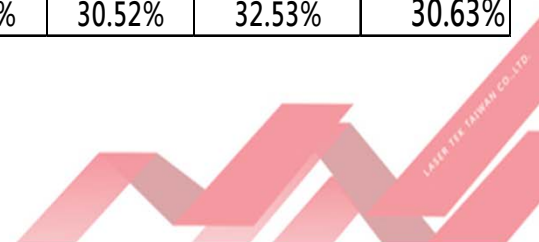


近10年合併營收與合併毛利率

單位：新台幣仟元/%

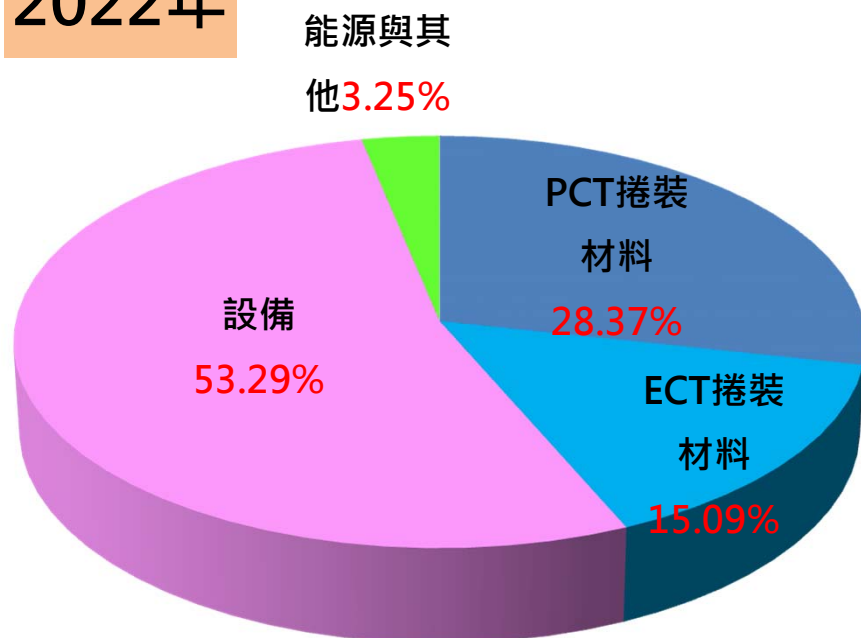


年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023/3Q
集團營收	1,913,318	1,941,943	1,995,668	2,004,536	2,287,415	2,211,070	1,078,330	1,221,008	1,751,466	1,386,770	776,739
集團毛利率	19.09%	25.70%	26.44%	25.31%	28.20%	29.23%	26.25%	29.75%	30.52%	32.53%	30.63%

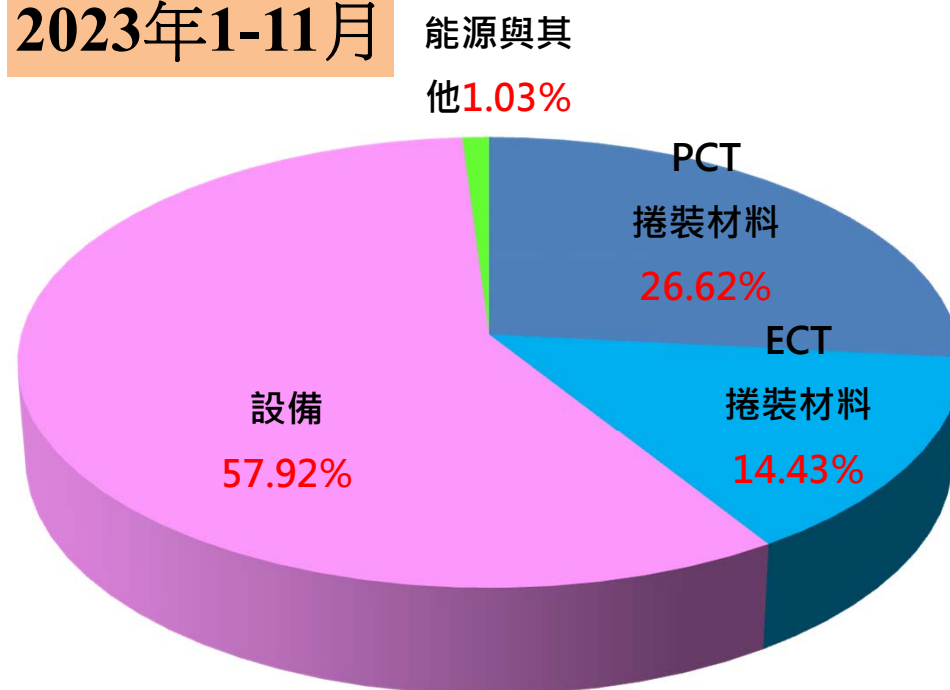


公司產品項目佔比

2022年



2023年1-11月

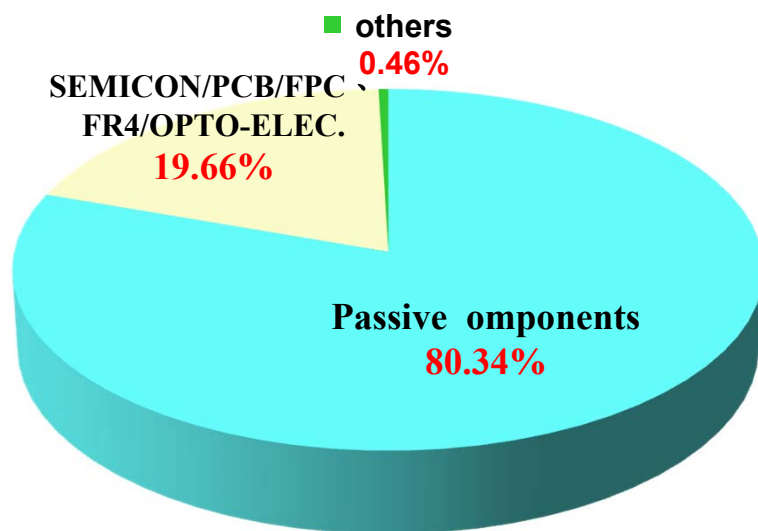


全球衛局翹楚品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案

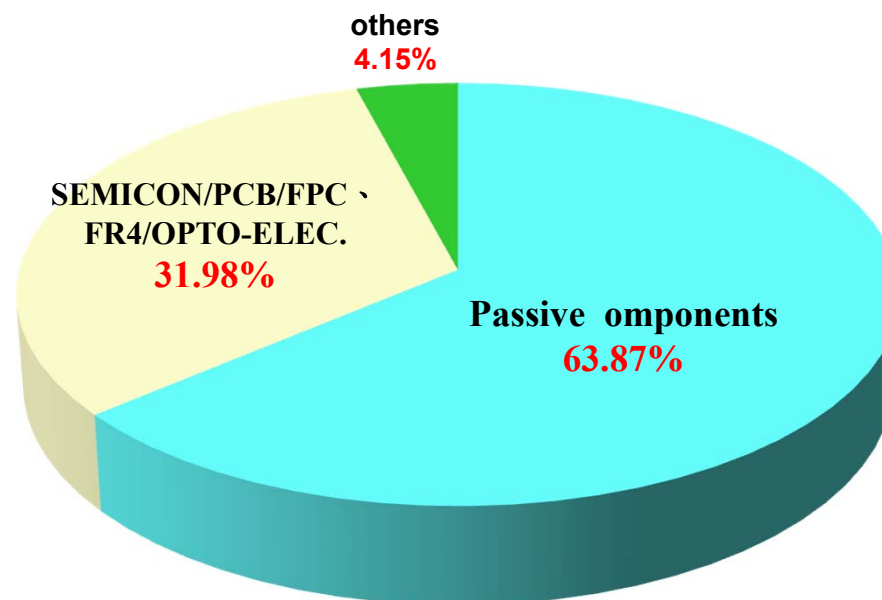


公司產品產業別佔比

2021年

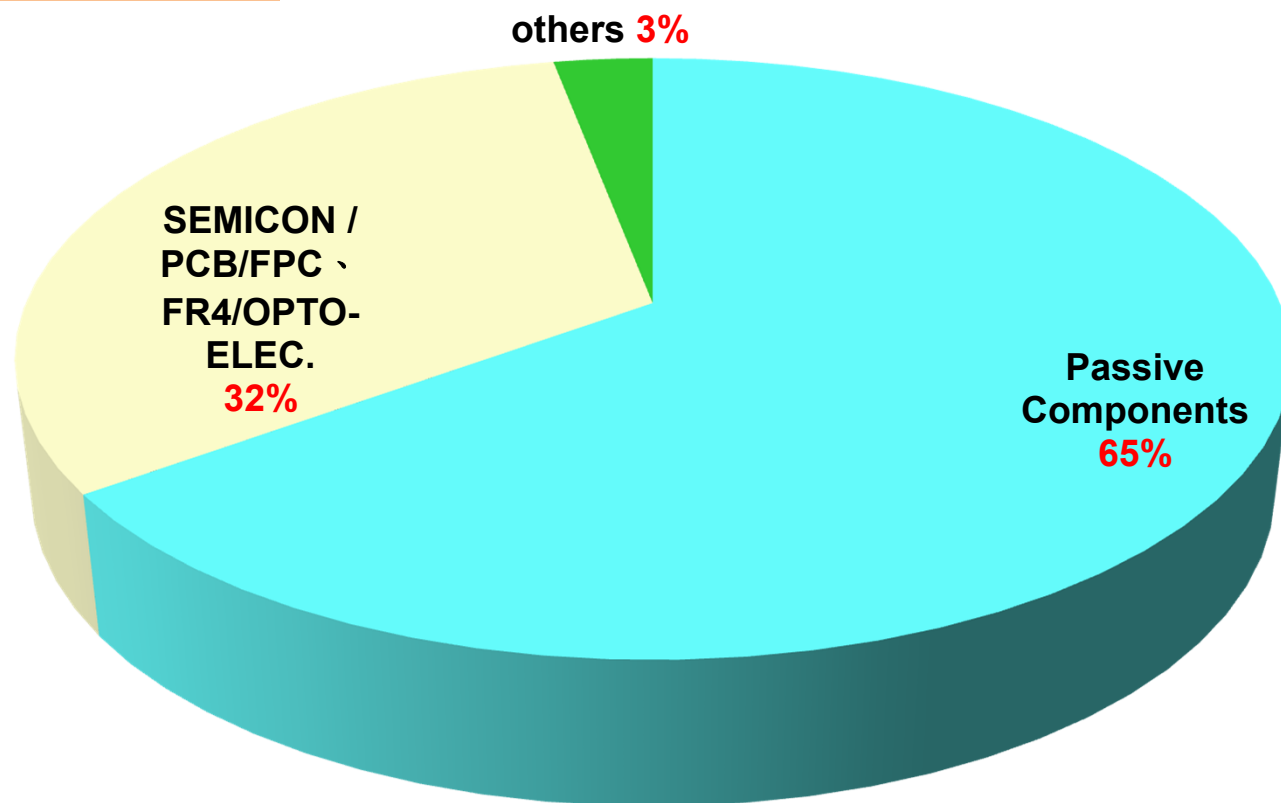


2022年

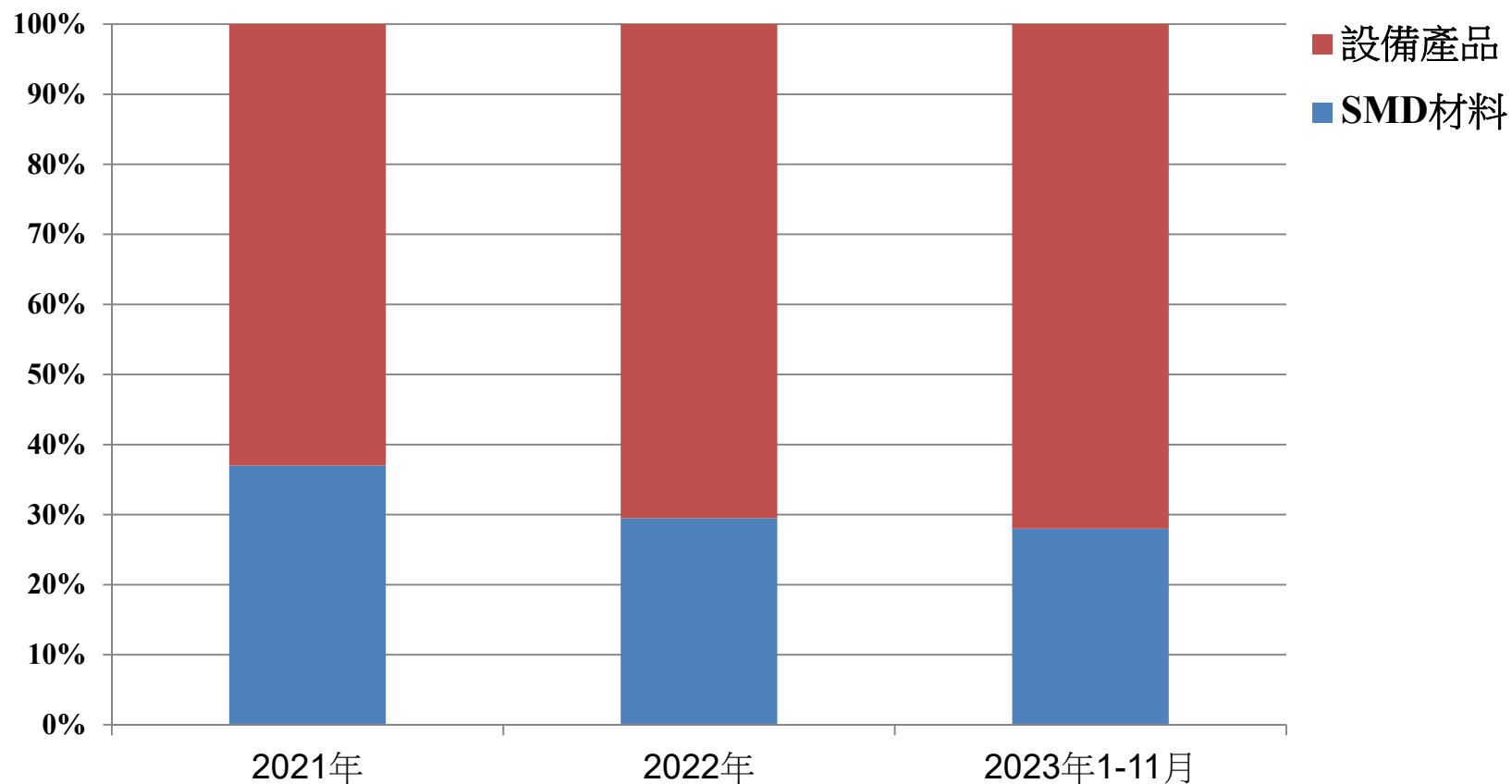


公司產品產業別佔比

2023年1-11月



公司產品類別毛利佔比



(三)

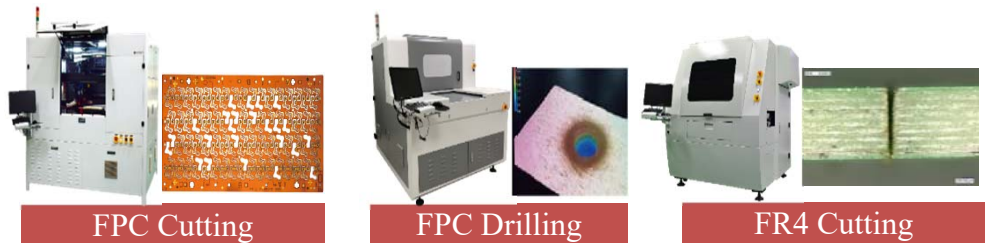
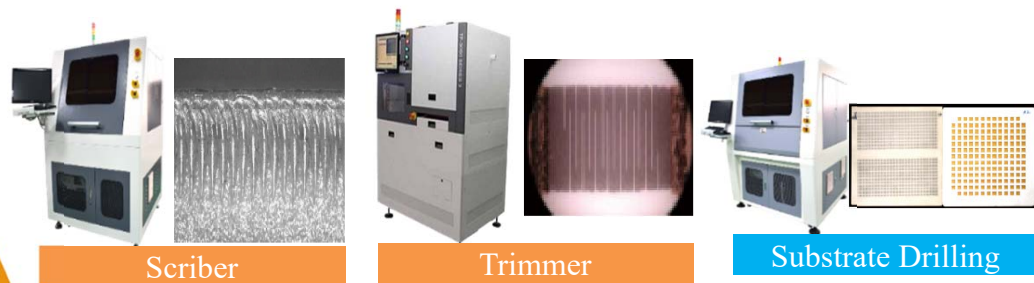
設備產品研發核心技術 與產業應用



全球奇聞品牌 · 聚焦核心光電技術 · 拓展利基新市場 · 提供完整服務方案



設備部門產品介紹與應用



Lasertek product solution

半導體



Wafer trim



Wafer marking



Wafer grooving

載板



FR4 cutting



substrate drilling



FPC cutting

被動元件



functional trim



Thin film trim



Tantalum trim

AI應用



AI+AOI缺陷檢查



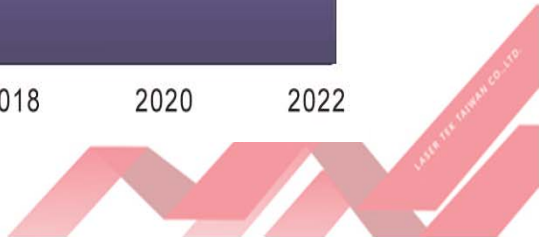
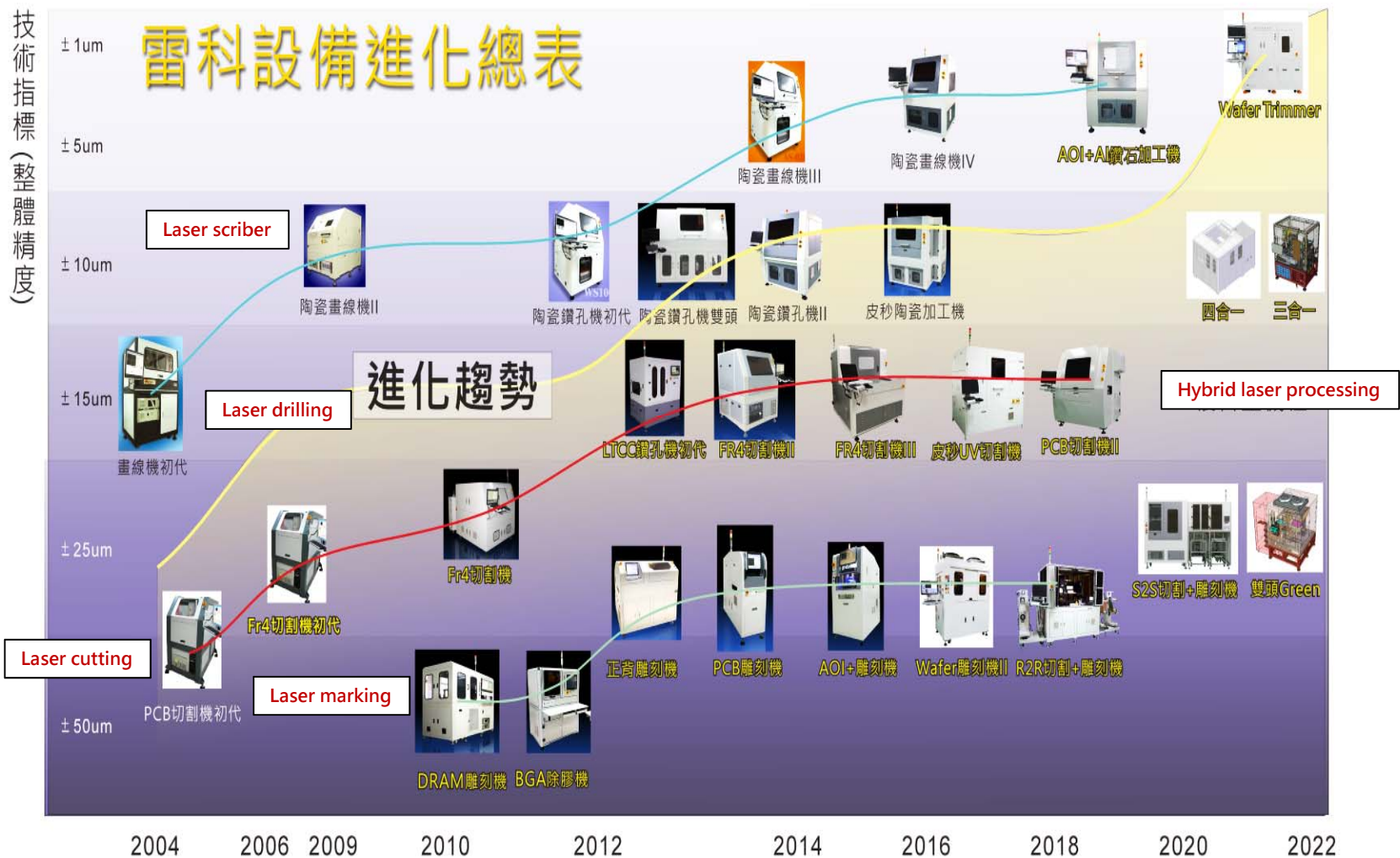
AI鑽石切割機



全球衛局雷射品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案



Lasertek 設備精度進化歷程



四大核心領域

半導體



- Wafer trim
- CoWoS
- LAB
- SIC cutting
- Glass wafer

載板



- FR4車用電子
- RF高頻散熱載板
- LCP 5G高頻FPC
- 量子電腦FPC

被動元件



- Thick film
- Thin film(高精度)
- Functional trim
- Tantalum trim

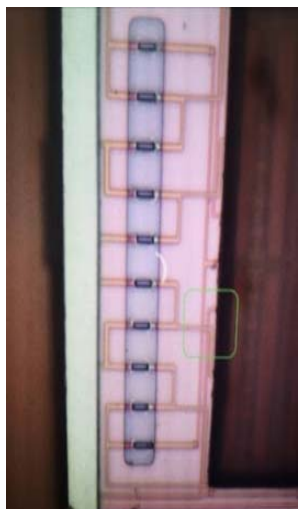
AI應用



- AI 缺陷檢查
- AI 鑽石切割



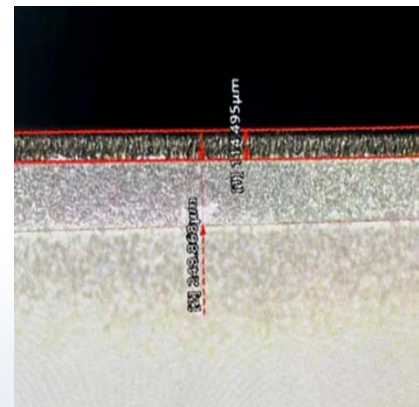
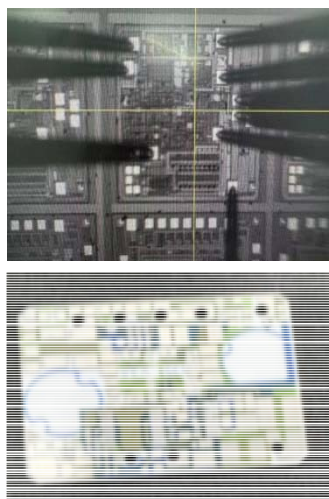
半導體領域 Wafer / SIC / Glass Wafer 應用



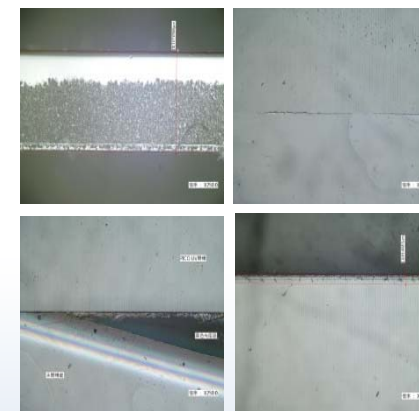
電源管理IC
1um加工總體精度
1%rms 能量穩定性



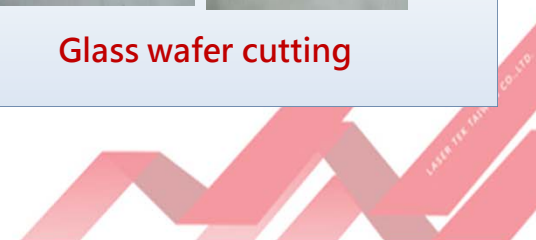
儀器放大IC
膜厚<1um修調



SIC cutting



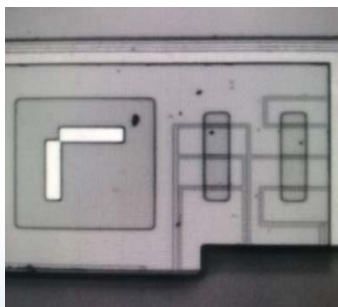
Glass wafer cutting



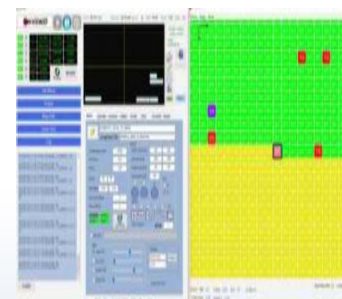
核心技術 Wafer Laser Trim 雷射晶圓修阻機



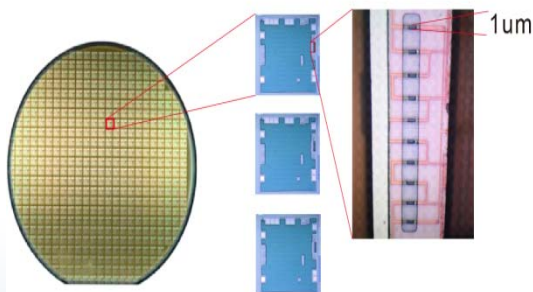
1uJ 高精度雷射功率補償技術



雷射同軸視覺，解析度<1um



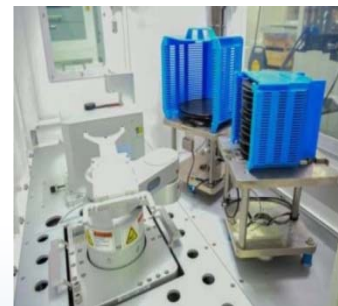
客製化mapping程式，支援multi die加工



1um的高精度加工



外掛電測儀器，支援20多種儀表

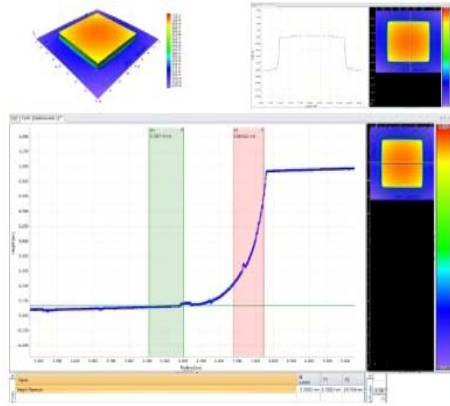


高精度robot 支援4-8吋

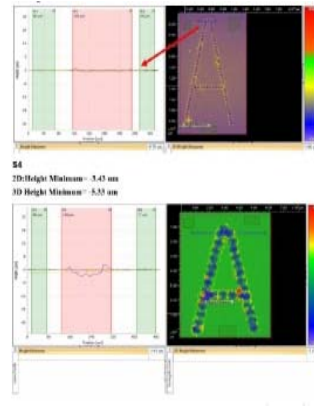




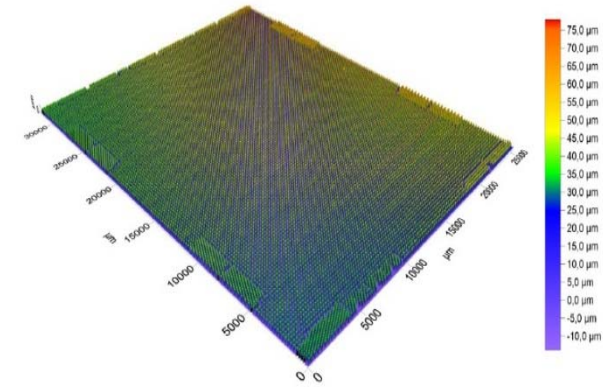
半導體領域 CoWoS 封裝量測



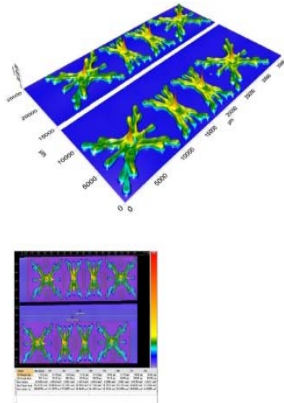
▲ UNDER-FILL GLUE FILLET HEIGHT



▲ LASER SCRIBING

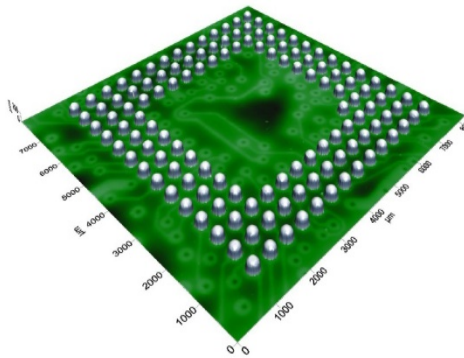


▲ C4 bump height ,diameter & warpage measurement (substrate surface side) by L-CHR

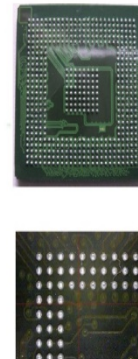


▲ SOLDER DISPENSED

Surface image of a Micro BGA



▲ HEIGHT, COPLANARITY –BGA SOLDER BUMPS



- CTWL200D
- CT350T
- CT450T
- CT600T (TTV)



- CT350
- CT450
- CT600



全球奇異品牌，聚焦核心光電技術，拓展利基藍海市場，提供完整服務方案





持續創新改善 全員追求卓越

感謝您的蒞臨

Thank you for coming here today.

LASER TEK TAIWAN CO., LTD.